

正本

檔 號：

保存年限：

國立清華大學 函

地址：新竹市光復路2段101號

承辦人：楊慧敏

電話：03-5715131#31181

電子信箱：hmyang@mx.nthu.edu.tw

110

臺北市信義區西村里信義路五段5號3號樓
3E41室

受文者：台灣電子製造設備工業同業公會

發文日期：中華民國115年8月6日

發文字號：清智財字第1159006238號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：優質研發成果讓與公告20260730-0830_王偉中.pdf

主旨：有關本校執行經濟部計畫產生之研發成果「精密光學應力檢測系統商業化-於先進封裝產業計畫(專利)」擬公開徵求授權對象，詳如說明，請協助轉知貴會所屬會員。

說明：

- 一、本校執行經濟部計畫產生之研發成果「精密光學應力檢測系統商業化-於先進封裝產業計畫」等相關專利，擬公開徵求授權對象，將於115年8月30日下午5時整截止收件。詳細資料請參考本校產學營運總中心網站<https://ocic.iih.nthu.edu.tw/>，隨函檢附本案公告內容1份。
- 二、本案聯絡人：本校智財技轉組楊專員，電話：03-5715131分機31181，電子信箱：hmyang@mx.nthu.edu.tw，地址：30013新竹市光復路二段101號創新育成大樓116室。

正本：台灣科學工業園區科學工業同業公會、台灣科技產業園區光學及精密儀器工業同業公會、台灣光學工業同業公會、台灣電子製造設備工業同業公會

副本：本校智財技轉組

校 長 高 航 出 國
副 校 長 呂 平 江 代 行

本案依分層負責規定授權單位主管決行



國立清華大學優質研發成果讓與公告

(截標日:115/08/30)

公告日期：115 年 07 月 30 日

有鑑於在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，企業掌握優質技術可形成強有力的防護網，並可藉此累積企業技術能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼；國立清華大學擬將其所擁有之優質研發成果，以讓與方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力及促進整體產業發展，並提昇研發成果運用效益。

- 一、主辦單位：國立清華大學（以下簡稱清華）
- 二、投標廠商資格：依中華民國法律登記成立之國內公司，且營業內容包含：面板&半導體封測之光學應力量化和缺陷檢測產業。
- 三、研發成果標的：內容明細請詳附件。

四、公開說明會：

1. 公開說明會將於民國 115 年 08 月 21 日辦理(時間及地點另行通知報名廠商)。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 115 年 08 月 10 日中午 12 時整(含)前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「精密光學應力檢測系統」專利之專屬授權案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予清華聯絡人（請詳十一、聯絡方式）進行報名。清華聯絡人將於 115 年 08 月 14 日(含)前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、投標方法：

1. 採「標的組合」方式投標，不分開投標/開標。
2. 採郵遞或親送方式投標，投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商印信（公司大小章），連同押標金、廠商基本資料表、設立文件：如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本，裝入信封



密封之，並在信封上註明“國立清華大學優質研發成果讓與案(截標日：115/08/30)投標”及投標廠商聯絡人姓名、電話，於115年08月30日下午17時整(含)前(以送達收據為憑)掛號寄達或親送至以下聯繫窗口，否則其投標視為無效。

■ 聯繫窗口

30013 新竹市光復路二段 101 號

國立清華大學 智財技轉組 收

3. 投標時，不得附加任何成交條件。
4. 廠商重複投標者，該廠商於該次標案之全部投標均視為無效。
5. 投標後不得以任何理由要求撤回或修改其投標單。

六、 押標金：

1. 押標金為總投標價格之10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「國立清華大學」。
3. 押標金需連同投標單於截標日115年08月30日(含)下午17時整(含)前一併掛號寄達或親送至清華，否則其投標視為無效；若有不足者，清華得要求投標廠商補足。若於決標前未能補足者，視為其投標無效。
4. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、 決標方法：

1. 開標時間為115年09月02日。
2. 開標時，先審查及確認投標資格、投標文件、押標金是否符合公告內容。
3. 投標資料符合公告內容的廠商，進行開標作業。



4. 得標與否由清華開標審議委員會會議決定，總評比分數最高者得標。
5. 同一標的有二家(含)以上總評比分數相同且投標金額均高於底價時，以總價高者得標；二家(含)以上總評比分數相同且投標金額均高於底價，且總價相同者，由清華現場抽籤決定，投標廠商不得異議。
6. 開標時將請律師到場監標。
7. 開標後將個別通知投標廠商開標結果(不公告得標者)
8. 對於流標、廢標或無效投標之標的，本校得逕洽第三人為讓與等交易行為。

八、 契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 10 個工作天內，與清華簽訂「研發成果讓與契約書」。
2. 得標廠商如屆時未與清華簽訂「研發成果讓與契約書」或未繳清應付款項時，清華得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經清華同意者，不在此限)，清華得另洽第三人為讓與等交易行為，得標廠商不得異議。
3. 得標廠商與簽訂「研發成果讓與契約書」者，需為同一人，否則清華得沒收簽約保證金並取消得標資格，清華得另洽第三人為讓與等交易行為，得標廠商不得異議。
4. 得標廠商簽署「研發成果讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「研發成果讓與契約書」之讓與價金。
5. 「研發成果讓與契約書」自雙方依法簽章後生效。
6. 得標廠商應遵守國家法律與經濟部暨所屬相關主管機關之法規、命令(包括但不限於境外實施等規定)。前述法令變動時，亦同。
7. 專利讓與登記手續及費用由得標廠商負責辦理與支付，清華將配合辦理讓與登記所需手續。契約生效日前之專利相關費用由清華負擔，得標廠商應自本契約生效日起負擔專利之相關費用。



8. 得標廠商同意其對於研發成果標的若有自行實施或授權或轉讓予第三人於大陸地區或其他我國管轄區域外等，應檢視該研發成果運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之情事，並遵守相關之法令規定自行向主管機關為必要之申請或取得核准及同意。
9. 得標廠商就研發成果標的，授予清華永久享有無償、全球、非專屬及不可轉讓之實施權利。此外，於簽署「研發成果讓與契約書」前，若清華已分別就研發成果標的之一部或全部與第三人簽訂授權契約者，或對第三人為不主張權利之承諾者，得標廠商同意容忍清華對相關特定人之授權，具於清華前揭授權有效範圍內，不對該相關特定人依據研發成果標的行使使用權。得標廠商嗣後若將研發成果標的專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
10. 得標廠商同意並承認「研發成果讓與契約書」僅為清華同意讓與研發成果標的予得標廠商。清華亦僅依本標案公告的研發成果現狀辦理本標案並讓與研發成果標的予得標廠商，清華不擔保研發成果標的無瑕疵、不擔保研發成果標的得向第三人主張權利或請求損害賠償、不擔保研發成果標的之合用性或商品化之可能性，且不擔保得標廠商利用研發成果標的所製造產品之產品責任。得標廠商或第三人因研發成果標的發生任何損害時，得標廠商同意清華無須負擔任何責任，包括相關侵權與瑕疵擔保責任。
「研發成果讓與契約書」生效後，研發成果標的之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，與清華無涉；清華亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。
11. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對依中華民國法律設立之第三人就本研發成果標的主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該第三人請求協商授權或讓與事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知清華。
12. 未得清華及/或計畫核定機關事前書面同意前，得標廠商在使用實施專利於商業用途時(包括但不限於產品、商品或服務之公開行銷、推廣或廣告文宣等)，不得以任何方式引用清華及/或計畫核定機關名稱、部徽、校徽或其他表徵，亦不得



以任何方式表示清華及/或計畫核定機關與得標廠商有任何關連。

九、 注意事項：

投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、標單、研發成果標的及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，清華保留最終之解釋與決定權利。

十、 領標方式：

有意投標者，請與清華國際產學營運總中心聯絡人（請見十一、聯絡方式）連絡。

十一、 聯絡方式：

公告／招標等問題請洽清華國際產學營運總中心聯絡人

國立清華大學 智財技轉組

電 話：03-571-5131 分機 31181

電子信箱：hmyang@mx.nthu.edu.tw

地 址：30013 新竹市光復路二段 101 號



附件：專利專屬授權標的

專利家族	國別	專利類別	專利申請號	狀態	專利名稱
家族一	台灣	發明	105140876	已獲證	光學材料應力量測方法及其系統
	美國	發明	15/618,145	已獲證	Stress Measurement Method and System For Optical Materials
	中國	發明	201710279745.X	已獲證	光學材料應力量測系統
	日本	發明	2017-100569	已獲證	光学材料の応力測定方法、及び、光学材料応力測定システム
家族二	台灣	發明	114122617	審查中	材料應力檢測方法及其系統
	中國	發明	202510804928.3	審查中	系統材料应力检测方法及其系统
	美國	發明	19/426,736	審查中	Material Stress Measuring Method and System
	日本	發明	2026-004025	審查中	材料応力測定方法および材料応力測定システム
	PCT	發明	PCT/CN2025/146974	審查中	Material Stress Measuring Method and System
家族三	台灣	發明	--	撰稿中	光學材料應力檢測方法及其系統
	中國	發明	--	撰稿中	光學材料應力檢測方法及其系統
	美國	發明	--	撰稿中	光學材料應力檢測方法及其系統
	日本	發明	--	撰稿中	光學材料應力檢測方法及其系統
	PCT	發明	--	撰稿中	光學材料應力檢測方法及其系統